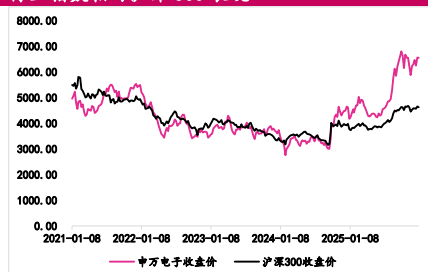


电子行业

2026年1月4日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
科森科技	20.94	21.82	116.19
信维通信	62.00	20.86	599.89
协创数据	168.68	15.53	583.84
东微半导	82.01	15.04	100.52
长盈精密	46.50	14.93	632.81
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
派瑞股份	11.02	-15.36	35.26
臻镭科技	122.07	-11.54	261.29
长光华芯	125.35	-11.19	220.97
*ST宇顺	29.17	-10.80	81.75
泓禧科技	35.39	-9.47	26.19

行业指数相对沪深300表现



相关报告

【金元电子】周报 20251130 太空数据中心建设，开启“天地协同新方案”

【金元电子】周报 20251207 DeepSeek V3.2 提升推理及 Agent 潜在能力

【金元电子】周报 20251215 3D NAND 或成为存储新增长曲线

【金元电子】周报 20251221 摩尔线程举办首届开发者大会，国产 AI 生态或加速

【金元电子】20251226 从“大模型训练”向“实时推理优先”转折

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangrj@jyzq.cn

行业周度点评报告

一中芯国际拟收购中芯北方或加速国产替代及先进制程进度

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数上涨0.13%，深证成指下跌0.58%，沪深300指数下跌0.59%，申万电子板块下跌0.16%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为13/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、信维通信、协创数据、东微半导、长盈精密；跌幅前五名分别为：派瑞股份、臻镭科技、长光华芯、*ST宇顺、泓禧科技。
- **电子行业：**本周电子行业各子板块涨跌幅分化明显，从申万二级行业数据看，各子板块录得不同程度涨跌幅，板块间分化特征突出。光学光电子板块本周涨幅居首，周涨幅为1.19%；其下申万三级行业中，面板上涨2.09%、LED上涨1.35%，而光学元件小幅下跌0.56%，板块内部表现分化明显。消费电子板块本周同样实现上涨，周涨幅为0.93%；其下申万三级行业中，消费电子零部件及组装上涨1.04%，而品牌消费电子小幅下跌0.34%，内部结构分化较为明显。半导体板块本周小幅调整，周跌幅为-0.32%，整体表现偏弱但内部差异显著；其下申万三级行业中，数字芯片设计上涨0.01%、集成电路封测上涨0.06%，而半导体材料下跌1.76%、半导体设备下跌1.02%、模拟芯片设计下跌0.54%、分立器件小幅下跌0.05%，细分领域表现分化。元件板块本周表现偏弱，周跌幅为-0.70%；其下申万三级行业中，印制电路板下跌0.67%，被动元件下跌0.81%，细分领域整体表现较为均衡。电子化学品板块本周下跌幅度较大，周跌幅为-2.72%；其下申万三级行业电子化学品III同步下跌-2.72%，板块内部走势一致。其他电子II板块本周跌幅居前，周跌幅为-2.91%；其下申万三级行业其他电子III同样下跌-2.91%，走势保持一致。总体来看，本周电子行业各子板块表现分化，既有板块实现上涨，也有板块出现调整，其中光学光电子、消费电子板块领涨；半导体、元件板块小幅调整；电子化学品、其他电子II板块领跌；部分板块内部出现明显分化，市场对不同细分方向的偏好存在差异。
- **行业要闻**
 - ◆ 中芯国际406亿元全资控股中芯北方，强化成熟制程工艺
 - ◆ SK海力士拟在美国投资2.5D先进封装产线
 - ◆ 紫光国微拟收购瑞能半导体控股权
 - ◆ IDC 警告，2026年PC市场出货量将减少9%，内存短缺将持续数年
 - ◆ 半导体需求拉动，韩国出口破7000亿美元
- **公司动态：**
 - ◆ 雅葆轩：股东拟减持股份的预披露公告
 - ◆ 本川智能：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
 - ◆ 芯原股份：关于作废处理部分限制性股票的公告
 - ◆ 海光信息：海光信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
 - ◆ 南芯科技：关于与关联方签署协议暨关联交易的公告
- **投资建议：**我们认为，本次中芯国际与国家大基金的运作主要体现了国内对先进制程及高端设备国产化落地的决心。一方面，中芯北方承载成熟制程及利润贡献的基石，另一方面，战略重心转向中芯南方，支持 SN1 项目继续扩大产能，通过规模化生产来打磨工艺，提升良率，降低单位成本；此外，作为国产化率最高的先进制程产线，中芯南方承担着验证国产光刻机、涂胶显影设备、薄膜沉积、蚀刻、量检等核心设备的重任。资金将用于采购和调试这些国产设备，加速全产业链的自主可控进程。
- **相关公司：**中芯国际、北方华创、中微公司、华海清科、盛美上海、中科飞测、拓荆科技、华虹公司、上海新阳、飞凯材料等
- **风险提示：**1、先进制程良率不及预期：缺乏 EUV 光刻机的情况下，通过 DUV 光刻机的多重曝光技术来实现工艺节点的量产，这种方法虽然理论上可行（台积电第一代 7nm 也是基于 DUV），但对工艺控制的精度要求极高，且步骤繁多导致成本上升、良率挑战巨大；2、地缘政治风险：国内代工厂已在努力推进设备国产化，但在光刻机、高端量测设备等核心领域，对 ASML、KLA 等海外厂商的依赖依然存在。如果美国进一步收紧出口管制，例如限制 DUV 光刻机的维保服务或备件供应，将对生产连续性造成一定影响。

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前金元在先

目录

一、核心观点3

二、行业跟踪5

三、行业新闻8

四、公司公告16

五、下周重要事件提示21

图 1：本周电子版块：子版块涨跌幅6

图 2：电子版块历史走势7

图 3：电子版块历史市盈率7

表 1：本周电子版块个股涨幅前五名5

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名5

表 3：下周重要会议21

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）22

一、核心观点

根据中芯国际发布的公告，公司拟通过发行股份购买资产的方式，收购国家集成电路产业投资基金股份有限公司（大基金一期）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（大基金二期）、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司等股东合计持有的中芯北方 49% 股权。交易总对价约 406 亿元人民币，支付方式为全额股份支付，不涉及现金流出，意味着中芯国际将向上述交易对方发行约 5.47 亿股人民币普通股，发行价格确定为 74.20 元/股。同时，中芯国际联合国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称“大基金三期”）、上海地方国资等战略投资者，向中芯南方集成电路制造有限公司（以下简称“中芯南方”）注入高达 77.78 亿美元的资金。

中芯北方作为中芯国际在北京基地的核心运营实体，其战略地位较高。中芯北方成立于 2013 年 7 月，是中芯国际与北京市政府、国家大基金共同打造的北方集成电路制造中心。经过十余年的建设与运营，中芯北方已建成两条月产能均为 3.5 万片的 300mm（12 英寸）晶圆生产线，合计月产能达 7 万片。由于中芯北方主要作为成熟制程的代工公司，其公司财务状况较为稳健。公告数据显示，2024 年度净利润超过 16 亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额更是高达 63.4 亿元人民币。2025 年 1-8 月，公司已实现营收 90.165 亿元，实现净利润 15.44 亿元，净利润率为 17.12%，较中芯国际净利润率高约 5.47pct。完成收购后，中芯国际净利润率或继续改善。

从技术节点来看，中芯北方主要聚焦于 28nm、40nm、55nm 等成熟制程工艺。虽然这些节点并非行业最前沿的先进制程工艺，但其服务领域较广，可实现成熟工艺的产能释放。特别是 28nm 节点，作为平面晶体管（Planar Transistor）架构的极致与性价比之王，被广泛应用于汽车微控制器（MCU）、图像传感器（CIS）、物联网连接芯片（IoT）、显示驱动芯片（DDIC）等领域。

中芯南方是中芯国际位于上海张江的先进工艺生产基地，本次交易中，中芯国际联合国家大基金三期、上海集成电路产业投资基金等战略投资者，向中芯南方注入了高达 77.78 亿美元的资金。根据最新的股权结构披露，增资完成后，中芯控股持有中芯南方 41.561% 的股权，国家大基金一期持有 9.392%，国家大基金二期持有 14.885%，而新进的国家大基金三期则一举持有 8.361% 的股权，泰新鼎吉持股 5.545%，先导集成电路基金持股 1.063%。

市场此前普遍预期，大基金三期将重点聚焦于“卡脖子”最严重的环节，包括 AI 芯片、高带宽内存（HBM）以及先进制程制造设备及材料。此次大基金三期将投资投向中芯南方，无疑验证了这一判断。中芯南方作为中芯国际 14nm 及以下先进工艺的主要承载平台（SN1 项目），其战略重要性不言而喻。

中芯南方所运营的 SN1 项目，是国内第一条 FinFET 工艺生产线。该产线不仅已

经实现了 14nm 工艺的量产，更在 N+1、N+2 等类 7nm 工艺上取得了关键性突破。在无法获得 ASML EUV 光刻机的极端困难条件下，中芯南方的技术团队不得不探索利用现有的 DUV（深紫外）光刻机，通过多重曝光（SAQP 等）技术来实现更小线宽的电路制造。本次资金注入或聚焦于以下三个方面：

- **产能扩充与良率提升：**支持 SN1 项目继续扩大产能，通过规模化生产来打磨工艺，提升良率，降低单位成本。
- **国产设备验证与导入：**作为国产化率最高的先进制程产线，中芯南方承担着验证国产光刻机、涂胶显影设备、离子注入机等核心装备的重任。资金将用于采购和调试这些国产设备，加速全产业链的自主可控进程。
- **AI 芯片制造能力建设：**随着国内 AI 大模型产业的爆发，对算力芯片的需求激增。中芯南方是目前国内唯一有能力承接高性能 AI 芯片代工任务的平台，其扩产直接关系到中国 AI 产业的基础设施安全。

从成熟制程转向先进制程是本次交易的核心。国家大基金运作退出成熟期资产，大基金一期和二期从中芯北方这一已经成熟、盈利稳定的项目中退出。这种退出是通过换股的方式，将持有的子公司股权转换为上市公司（中芯国际）的母公司股权，既实现了投资回报，又保持了中芯国际整体的战略影响力，同时将中芯国际上市公司的国有持股比例进一步提升。并且，腾挪出来的资金额度与新募集的大基金三期资金，转向风险较高但战略意义巨大的先进制程。

我们认为，本次中芯国际与国家大基金的运作主要体现了国内对先进制程及高端设备国产化落地的决心。一方面，中芯北方承载成熟制程及利润贡献的基石，另一方面，战略重心转向中芯南方，支持 SN1 项目继续扩大产能，通过规模化生产来打磨工艺，提升良率，降低单位成本；此外，作为国产化率最高的先进制程产线，中芯南方承担着验证国产光刻机、涂胶显影设备、薄膜沉积、刻蚀、量检等核心设备的重任。资金将用于采购和调试这些国产设备，加速全产业链的自主可控进程。

相关公司：

半导体产业链：中芯国际、北方华创、中微公司、华海清科、盛美上海、中科飞测、拓荆科技、华虹公司、上海新阳、飞凯材料等

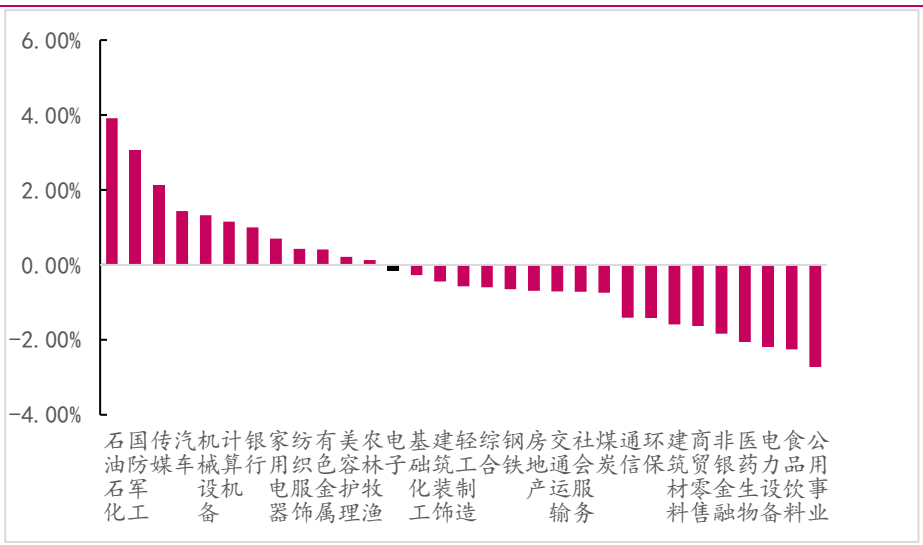
风险提示：

- 1、**先进制程良率不及预期：**缺乏 EUV 光刻机的情况下，通过 DUV 光刻机的多重曝光技术来实现工艺节点的量产，这种方法虽然理论上可行（台积电第一代 7nm 也是基于 DUV），但对工艺控制的精度要求极高，且步骤繁多导致成本上升、良率挑战巨大。
- 2、**地缘政治风险：**国内代工厂已在努力推进设备国产化，但在光刻机、高端量测设备等核心领域，对 ASML、KLA 等海外厂商的依赖依然存在。如果美国进一步收紧出口管制，例如限制 DUV 光刻机的维保服务或备件供应，将对生产连续性造成一定影响。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025.12.29-2026.1.2）本周上证指数上涨 0.13%，深证成指下跌 0.58%，沪深 300 指数下跌 0.59%，申万电子版块下跌 0.16%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 13/31。板块个股涨幅前五名分别为：科森科技、信维通信、协创数据、东微半导体、长盈精密；跌幅前五名分别为：派瑞股份、臻镭科技、长光华芯、*ST 宇顺、泓禧科技。

图 1：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所整理

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
603626.SH	科森科技	21.82	20.94	16.00	21.48	62.58	347.25	65.78
300136.SZ	信维通信	20.86	62.00	49.88	62.00	66.92	551.79	302.21
300857.SZ	协创数据	15.53	168.68	144.00	172.00	15.94	55.00	86.72
688261.SH	东微半导体	15.04	82.01	72.17	84.95	22.72	27.74	22.31
300115.SZ	长盈精密	14.93	46.50	39.60	47.99	34.46	467.60	204.71

数据来源：Choice，金元证券研究所整理

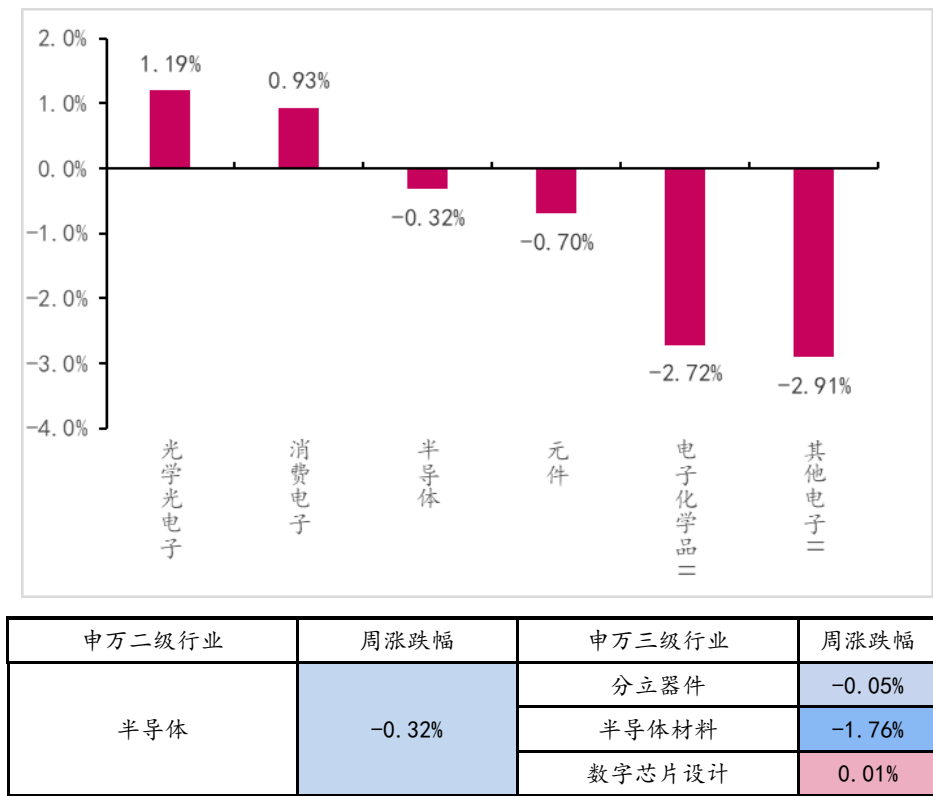
表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300831.SZ	派瑞股份	-15.36	11.02	10.88	11.79	24.22	44.68	5.02
688270.SH	臻镭科技	-11.54	122.07	115.03	134.30	61.06	130.71	162.45
688048.SH	长光华芯	-11.19	125.35	124.00	138.50	26.14	46.08	60.40
002289.SZ	ST 宇顺	-10.80	29.17	29.17	33.80	3.09	8.64	2.76
871857.BJ	泓禧科技	-9.47	35.39	34.33	38.99	9.19	6.81	2.44

数据来源：Choice，金元证券研究所整理

电子行业：本周（2025.12.29 - 2026.1.2）电子行业各子板块涨跌幅分化明显，从申万二级行业数据看，各子板块录得不同程度涨跌幅，板块间分化特征突出。光学光电子板块本周涨幅居首，周涨幅为1.19%；其下申万三级行业中，面板上涨2.09%、LED上涨1.35%，而光学元件小幅下跌0.56%，板块内部表现分化明显。消费电子板块本周同样实现上涨，周涨幅为0.93%；其下申万三级行业中，消费电子零部件及组装上涨1.04%，而品牌消费电子小幅下跌0.34%，内部结构分化较为明显。半导体板块本周小幅调整，周跌幅为-0.32%，整体表现偏弱但内部差异显著；其下申万三级行业中，数字芯片设计上涨0.01%、集成电路封测上涨0.06%，而半导体材料下跌1.76%、半导体设备下跌1.02%、模拟芯片设计下跌0.54%、分立器件小幅下跌0.05%，细分领域表现分化。元件板块本周表现偏弱，周跌幅为-0.70%；其下申万三级行业中，印制电路板下跌0.67%，被动元件下跌0.81%，细分领域整体表现较为均衡。电子化学品板块本周下跌幅度较大，周跌幅为-2.72%；其下申万三级行业电子化学品III同步下跌-2.72%，板块内部走势一致。其他电子II板块本周跌幅居前，周跌幅为-2.91%；其下申万三级行业其他电子III同样下跌-2.91%，走势保持一致。总体来看，本周电子行业各子板块表现分化，既有板块实现上涨，也有板块出现调整，其中光学光电子、消费电子板块领涨；半导体、元件板块小幅调整；电子化学品、其他电子II板块领跌；部分板块内部出现明显分化，市场对不同细分方向的偏好存在差异。

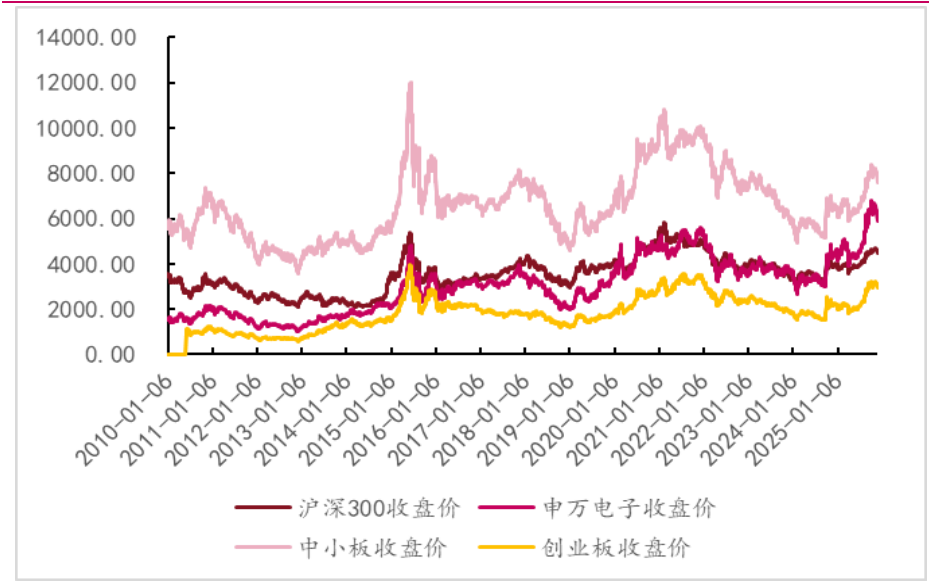
图 1：本周电子版块：子版块涨跌幅



		模拟芯片设计	-0.54%
		集成电路封测	0.06%
		半导体设备	-1.02%
元件	-0.70%	印制电路板	-0.67%
		被动元件	-0.81%
光学光电子	1.19%	面板	2.09%
		LED	1.35%
		光学元件	-0.56%
消费电子	0.93%	品牌消费电子	-0.34%
		消费电子零部件及组装	1.04%
电子化学品	-2.72%	电子化学品 III	-2.72%
其他电子	-2.91%	其他电子 III	-2.91%

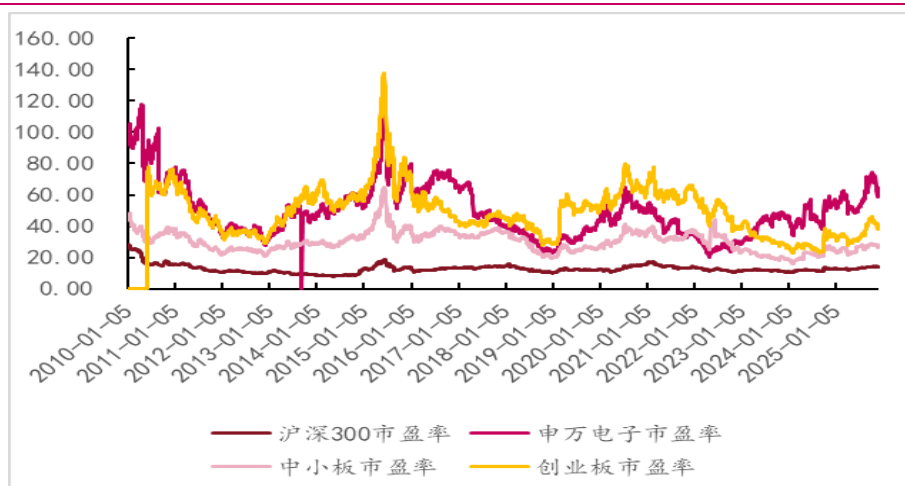
数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

图 2: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

图 3: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

三、行业新闻

SK海力士拟在美国投资2.5D先进封装产线

12月29日据《心安纪》报道，全球领先的存储芯片制造商SK海力士正计划进行一项战略性投资，旨在超越高带宽内存（HBM）领域，全面掌握最先进的封装技术。该公司正着手准备在美国新建的封装工厂内建立其首条2.5D封装量产线。月度贸易顺差预测中值为100亿美元。这将高于上月的97.4亿美元，也是自2017年9月以来的最大顺差。2.5D封装是集成HBM与高性能系统半导体（如GPU、CPU）的核心工艺。分析认为，若SK海力士成功掌握2.5D封装技术及量产能力，预计将对AI半导体供应链格局产生重大影响。

Tower Semiconductor将参加第28届Needham

12月29日据《心安纪》报道，领先的高价值模拟半导体解决方案代工厂Tower Semiconductor今天宣布，其公司代表将参加1月13日和1月14日举行的第28届Needham年度增长大会。本次会议将在纽约乐天纽约皇宫酒店举行。届时，投资者将有机会与公司代表进行一对一会谈。Tower Semiconductor Ltd. 是领先的高价值模拟半导体解决方案代工厂，为消费电子、工业、汽车、移动、基础设施、医疗以及航空航天和国防等新兴市场的客户提供技术、开发和工艺平台。Tower Semiconductor致力于通过长期合作关系及其先进创新的模拟技术产品，为世界带来积极且可持续的影响。其产品涵盖广泛的可定制工艺平台，例如SiPho、SiGe、BiCMOS、混合信号/CMOS、射频CMOS、CMOS图像传感器、非图像传感器、显示器、集成电源管理（BCD和700V）、光子学和MEMS。Tower Semiconductor还为IDM和无晶圆厂公司提供世界一流的设计支持，以实现快速准确的设计周期，以及包括开发、转移和优化在内的工艺转移服务。

苹果公司将避免中国芯片新关税的影响

12月29日据《心安纪》报道，据联邦公报显示，尽管美国仍将对来自中国的半导体进口征收新关税，但实际关税税率将在约18个月内维持在零水平。关税税率将于2027年6月23日上调，具体上调幅度将至少提前30天公布。对苹果公

司而言，这项决定消除了其产品中使用的多种芯片在短期内进口成本上涨的风险。虽然苹果公司自行设计A系列和M系列处理器，并由台积电在台湾生产，但该公司仍然依赖中国供应商提供许多其他半导体组件，包括电源管理集成电路、显示驱动芯片、连接控制器以及嵌入其设备中的各种支持逻辑芯片。一旦2027年中国半导体关税税率上调，其中许多组件都将受到该关税的影响。尽管从技术上讲，关税立即生效，但零税率实际上是一种延迟机制，而非暂停措施。这既保留了日后提高关税所需的法律和监管框架，减少了眼前的贸易摩擦，又为未来的谈判保留了筹码，并为像苹果这样的公司在制定长期供应链决策时提供了清晰的指引。对苹果公司而言，此次举措的时机尤为重要，因为该公司正持续努力实现生产和采购多元化，摆脱对中国市场的依赖。此前，苹果曾面临半导体进口可能被征收100%关税的担忧。

台积电涨价

12月29日据《创芯网》报道，受益于AI应用热潮席卷全球，台积电3纳米及以下先进制程产能持续供不应求。业界消息称，台积电已与客户达成沟通共识，计划在2026年至2029年期间连续四年调升先进制程报价，其中2026年新报价将于元旦起正式生效。多家投资机构看好，此番涨价将为台积电2026年首季业绩注入强劲动力，助力其打破传统淡季魔咒，实现业绩持平甚至小幅超越本季度的亮眼表现，向历年最强首季发起冲击。台积电定于2026年1月15日召开实体法说会，届时市场目光将高度聚焦两大核心议题——2026年首季业绩展望，以及先进制程涨价的具体落地细节。在需求端，投资机构分析指出，台积电首季淡季不淡的关键支撑，来自头部客户的密集出货计划。英伟达、AMD等AI芯片巨头的新平台将陆续面市，博通等非苹果阵营客户也在加速拓展AI应用领域，多重需求共振之下，直接推动台积电3纳米以下先进制程产能供需缺口持续扩大。

小米联合创始人林斌拟减持套现140亿元

12月29日据《电子工程专辑》报道，2025年12月28日晚间，小米集团发布公告称，公司联合创始人、执行董事兼副董事长林斌，计划自2026年12月起，启动一项为期四年、累计套现金额不超过20亿美元（约合人民币140亿元）的股份减持计划。这一涉及金额巨大的资本操作，使得这位长期被视为公司“二号人物”的创始元老，其个人财富配置与公司发展之间的关系，成为业界关注的焦点。根据小米集团发布的公告，林斌的减持计划将按周期分步实施。具体方案为：自2026年12月开始，以每12个月为一个周期，每个周期内出售不超过5亿美元的公司B类普通股，整个计划的累计出售总金额上限锁定在20亿美元。这意味着，若按计划全额实施，整个减持过程将持续四年，直至2030年。公告同时强调，林斌在公告中表达了对小米集团业务前景的长期信心，并承诺将继续长期服务于集团。截至2025年中期财报数据，林斌合计持有小米约23.3亿股，持股比例为8.96%。以小米当前股价估算，此次减持计划涉及的股份数量可观。

紫光国微拟收购瑞能半导体控股权

12月30日据《电子工程专辑》报道，12月29日，紫光国微发布一则重磅公告，

宣布公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买南昌建恩半导体产业投资中心（有限合伙）、北京广盟半导体产业投资中心（有限合伙）、天津瑞芯半导体产业投资中心（有限合伙）等交易对方持有的瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“瑞能半导”）控股权或全部股权，并同步募集配套资金。这一举措迅速引发了市场的广泛关注，紫光国微股票及可转换公司债券自2025年12月30日起开始停牌，预计不超过10个交易日内披露交易方案。紫光国微作为紫光集团旗下的综合性半导体上市企业，一直聚焦于特种集成电路、智能安全芯片两大主业，并涵盖石英晶体频率器件、功率半导体等重要业务。此次拟收购的瑞能半导，则是一家成立于2015年的中外合资企业，曾为恩智浦（NXP）子公司，注册资本为3.62亿元，注册地址位于江西省南昌市。瑞能半导主要经营半导体产品的研发、设计、生产和销售，其业务覆盖半导体全产业链环节，与紫光国微的主营业务高度契合。

2026年全球半导体行业10大技术趋势

12月30日据《电子工程专辑》报道，2025年，全球半导体产业在挑战与机遇中稳步前行。据世界半导体贸易统计协会（WSTS）数据显示，2025年全球半导体市场规模预计超过7,000亿美元，同比增长约11.2%，其中人工智能（AI）与高性能计算（HPC）相关芯片增速显著，推动了先进工艺、封装及存储技术的不断创新。在技术层面，2nm工艺节点进入量产关键阶段，台积电N2工艺晶体管密度成为行业标杆；英特尔18A工艺凭借环栅场效应管（GAAFET）与背面供电网络（BSPDN）技术的创新应用，实现性能与能效的双重突破。与此同时，存算一体、芯粒（Chiplet）、共封装光学（CPO）等前沿技术加速落地。北京大学、南京大学、中科院微电子所等机构在存算一体领域取得突破性进展；imec成功实现250nm间距的3D键合，为逻辑-内存异构集成提供关键支撑；英伟达推出集成硅光引擎的CPO交换芯片，显著提升能效与部署效率，推动该技术在AI超级集群中走向早期应用。

中芯国际406亿元全资控股中芯北方，强化成熟制程工艺

12月30日据《电子工程专辑》报道，12月29日晚间，中芯国际发布公告，宣布拟以406亿元人民币的价格，向国家集成电路产业投资基金等5名股东发行股份，收购其持有的中芯北方49%股权。交易完成后，中芯国际将实现对中芯北方100%控股，后者正式成为其全资子公司。中芯北方是中芯国际旗下专注于12英寸集成电路晶圆代工的重要基地，主要提供涵盖成熟制程至先进节点的多样化工艺平台服务，广泛应用于消费电子、物联网、汽车电子及工业控制等领域。作为中芯国际重要的收入和利润来源之一，中芯北方的产能利用率长期处于高位。此次全资控股，将使中芯国际在财务并表、资源调配、技术研发和客户响应等方面获得更大灵活性与统一性，显著增强整体运营效率。中芯国际近期发布的2025年第三季度财报显示，公司前三季度实现营收495.10亿元，同比增长18.2%；净利润达38.1亿元，同比大增41.1%。业绩增长主要受益于晶圆出货量提升及产品组合优化。

芯耀辉完成IPO辅导

12月30日据《电子工程专辑》报道，12月28日，中国证监会官网披露，芯耀辉科技股份有限公司及其辅导券商国泰君安已向上海证监局提交了辅导工作完

成报告，标志着这家专注于高速互连技术及先进半导体IP的企业正式完成首次公开发行股票并上市的辅导工作，向资本市场迈出了关键一步。自成立以来，芯耀辉先后获得了红杉、高瓴等一众知名投资机构的青睐，完成了多轮融资。今年5月，芯耀辉宣布完成B轮融资，中国互联网投资基金、上海国投等知名机构参与投资，为公司的持续发展提供了强有力的资金支持。2025年4月，芯耀辉正式提交了IPO辅导备案，聘请国泰君安作为其首次公开发行股票并上市的辅导机构。经过数月的辅导工作，芯耀辉在合规性、公司治理等维度已满足资本市场入门要求，辅导工作顺利完成。此次辅导工作的完成，不仅为芯耀辉的IPO之路奠定了坚实基础，也进一步提升了公司在半导体IP领域的市场影响力。随着人工智能、数据中心和高性能计算等领域的快速发展，半导体IP作为芯片设计的核心要素，其重要性日益凸显。芯耀辉作为国产半导体IP研发与服务的领军企业，其上市不仅将为公司自身的技术研发、业务扩张注入新动能，也有望进一步推动国内半导体IP产业链的自主化进程。

软银40亿美元收购DigitalBridge，押注AI基础设施赛道

12月30日据《电子工程专辑》报道，12月29日，日本软银宣布将以约40亿美元（约合280.6亿元人民币）的总价，全资收购美国数字基础设施巨头DigitalBridge集团，将其私有化。软银此次收购是其AI战略的重要一环。就在不久前，软银已出售所持全部英伟达股份，套现约58.3亿美元为AI新投资腾挪资金。这笔资金正被用于支持包括OpenAI合作、数据中心建设及本次DigitalBridge收购在内的多项AI基础设施项目。软银首席执行官兼董事长孙正义表示，此次收购“将加强下一代人工智能数据中心的基础”，并推进公司成为领先的“人工智能超级智能”平台提供商的愿景。孙正义在一份声明中表示：“随着人工智能改变全球各行各业，我们需要更多的计算能力、连接性、电力和可扩展的基础设施。”而DigitalBridge正是这一逻辑下的理想标的。

集邦咨询：在内存涨价潮中，苹果要比友商更从容

12月31日据《IT之家》报道，市场调查机构集邦咨询TrendForce最新预测，受内存价格飙升影响，2026年全球笔记本电脑出货量将同比下降5.4%。然而，苹果凭借其一体化供应链、强大定价权及稳定的采购量，受此市场冲击的程度预计较小。集邦咨询TrendForce在最新报告中指出，由于经济复苏步伐缓慢且消费者支出保持谨慎，全球笔记本电脑市场正面临新的挑战，尤其是持续飙升的内存价格，正在严重挤压各大笔记本品牌的利润空间与定价自由度。因此集邦咨询已下调了2026年的全球笔记本电脑出货量预测，预估出货量为1.73亿台，同比下降5.4%。集邦咨询分析，进一步指出了潜在的下行风险。如果内存价格的上涨趋势在2026年第二季度前未能得到有效遏制，同时品牌方又无法将增加的成本顺利转嫁给消费者，那么市场对入门级和消费级笔记本电脑的需求可能会出现更大幅度的下滑。在这种悲观情景下，2026年全年的出货量降幅可能扩大至10.1%，市场收缩将更为严重。

软银完成对 OpenAI 的 225 亿美元追加投资，总持股比例约 11%

12月31日据《IT之家》报道，软银集团今日在一份声明中表示，已于12月26日完成对OpenAI的 225 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1578.74 亿元人民币）追加投资，至此已完全履行其3月承诺的对OpenAI投资义务，目前在OpenAI的总持股比例约为11%。软银称，加上其他第三方共同投资者超额认购并增额参

与的110亿美元，最终总额410亿美元（现汇率约合 2876.81 亿元人民币）的投资承诺现已全额到位。此次最新投资的部分资金，来自以芯片设计公司Arm的股权为抵押的贷款，且动用了115亿美元的全部未使用信贷额度。今年4月，软银与21家金融机构达成了一笔150亿美元的过桥贷款。2025财年，软银在日本及海外市场持续发行债券，在不计赎回金额的情况下，累计募资93亿美元。自2024年9月起，软银便通过旗下愿景基金（SoftBank Vision Fund）多次向OpenAI注资。今年4月，软银曾承诺分两阶段向OpenAI投资，总规模最高可达300亿美元。当月，软银实际支付了75亿美元，并于10月决定在年底前完成剩余225亿美元的投资。软银集团董事长兼首席执行官孙正义在今年6月的股东大会上表示：“我认为OpenAI最终将会上市，并成为全球市值最高的公司。”

AI 红利，消息称三星半导体员工喜提2025年薪43%-48%绩效奖金

12月31日据《IT之家》报道，三星电子计划于2026年初向其半导体（DS）部门员工发放年薪43-48%的巨额绩效奖金，该比例是2024年（14%）的三倍以上。该媒体指出得益于全球内存市场的持续紧张，以及DRAM和高带宽内存（HBM）需求的激增，三星电子的半导体业务迎来了强劲的复苏。公司因此宣布，其负责半导体业务的设备解决方案（DS）部门员工将在2026年初获得2025年度的超额利润激励（OPI），预计发放比例将达到员工年薪的43-48%，这一数字相较于2024年14%的比例，实现了超过三倍的惊人增长。此次奖金大幅提升的核心驱动力，源于三星在尖端内存技术上的领先地位。三星不仅在第五代HBM（HBM3E和HBM4）技术上取得突破、超越了竞争对手美光，还成功获得了英伟达下一代AI GPU的HBM3E供应订单。同时，公司为保证利润最大化，已将部分生产重心转向DDR5内存，为预计在2026年实现730亿美元的营业利润打下坚实基础。除了在AI领域的成功，三星在消费电子市场也获得了关键客户的支持。据悉，苹果公司已将三星选为其 [iPhone17](#) 及未来 [iPhone18](#) 机型LPDDR5X内存芯片的最大供应商。来自苹果的稳定大额订单，将进一步巩固三星半导体业务的营收复苏，并直接转化为员工的丰厚回报。

IDC 警告，2026年PC市场出货量将减少9%，内存短缺将持续数年

12月31日据《IT之家》报道，IDC发布了其设备市场展望的最新更新报告，核心结论直截了当：市场形势正持续恶化。根据新披露的悲观情景预测，2026年个人电脑（PC）出货量降幅或高达9%；而在温和情景下，市场萎缩幅度也将达到5%。这两组数据均较IDC 11月预测报告中给出的2.5%降幅进行了下调。自11月预测发布以来，始于10月中旬的全球存储器短缺问题愈演愈烈，严重程度超出了IDC最初的模型测算。尽管该机构尚未正式全盘改写其官方预测，但目前提出的各类情景假设，已较短短几周前的预期显著悲观。IT之家注意到，导致这一局面的核心驱动力，与2025年末扰乱整个科技行业的因素如出一辙：人工智能（AI）基础设施建设。超大规模企业对存储器的需求激增，使得动态随机存取存储器（DRAM）和闪存（NAND）的产能布局出现结构性调整——产能从消费级设备领域，转向高带宽存储器、高密度DDR5等利润率更高的企业级产品。对存储器制造商而言，这是一个经济上合理的选择，但IDC明确指出，这并非一轮典型的行业繁荣-萧条周期，而是硅片产能的战略性重新分配，这种趋势可能持续数年，而非以季度为单位的短期波动。

消息称SK海力士美国首厂引入2.5D封装线，布局AI芯片的“最后一公里”

12月31日据《IT之家》，SK海力士计划在位于印第安纳州西拉斐特的美国首家工厂内，建设首条2.5D先进封装量产线。作为该公司的首个美国生产基地，该项目总投资达38.7亿美元，目标于2028年下半年投产。该媒体指出该工厂被定位为“AI内存先进封装生产基地”，标志着该公司试图超越单纯的HBM（高带宽内存）供应商角色，向更下游的先进封装领域扩张。2.5D封装是制造高性能AI芯片的“最后一公里”，该技术通过在芯片与基板之间插入一层硅中介层，将HBM与GPU、CPU等逻辑芯片紧密集成，从而大幅提升数据传输速度并降低功耗。SK海力士若能掌握这一核心工艺，将不再局限于提供内存组件，而是具备了生产完整AI芯片模块的能力。SK海力士推进此举的另一大动因在于提升产品可靠性。HBM目前需在集成到2.5D封装后才能进行最终的质量测试。若在封装环节发现故障，责任归属往往难以界定，且严重拖累交付进度。通过自建量产线，SK海力士可实现内部闭环测试，在出厂前即确保HBM与2.5D工艺的适配性，从而大幅降低良率风险，确立对竞争对手的质量优势。

Space Forge在轨道上的ForgeStar-1上点燃等离子体，发展太空半导体技术

1月1日据《心安纪》报道，英国初创公司Space Forge于12月31日宣布，其ForgeStar-1卫星成功生成等离子体，并称这是全球首例商业太空制造。该公司表示，这一里程碑式的成就使其在近地轨道生产高性能半导体材料的目标更进一步。Space Forge公司表示，此次等离子体实验表明，该公司能够创造气相晶体生长所需的极端条件，这是利用蒸汽形成半导体晶体的核心步骤。这家位于卡迪夫的公司致力于研发宽带隙和超宽带隙材料，例如氮化镓和碳化硅，这些材料广泛应用于高功率电子器件和先进通信等领域。据《科学美国人》报道，在轨制造技术的发展主要依赖于国际空间站上的实验，但此次演示是在一艘商业航天器上进行的无人操作。“这项演示表明，仅使用机器即可在太空制造半导体晶体，”战略与国际研究中心航空航天安全项目副主任克莱顿·斯沃普表示。

半导体需求拉动，韩国出口破7000亿美元

1月1日据《心安纪》报道，韩国官方数据显示，在全球半导体需求持续走强的带动下，韩国2025年出口总额创下历史新高。尽管美国总统特朗普发起的关税措施令全年贸易环境面临不利影响，韩国出口仍保持增长态势。韩国产业部门星期四（1月1日）公布的数据显示，韩国2025年出口总额超过7000亿美元，较前一年增长3.8%，规模和增幅均处于历史高位。随着人工智能在全球范围内快速发展，相关硬件需求明显上升，直接推高半导体出口表现。数据显示，韩国半导体产业2025年出口额达到1734亿美元，刷新历史纪录，比前一年增长超过20%。产业部门表示，用于人工智能数据中心的高价存储芯片需求持续强劲，成为拉动出口的重要动力。韩国科技企业在全球半导体供应链中占据重要位置。三星电子是全球主要存储芯片制造商之一，为人工智能产业及其所依赖的基础设施提供关键零部件。

平均150万美元，OpenAI员工年薪领跑新创

1月1日据《心安纪》报道，人工智能企业OpenAI近日向投资人披露的财务资料显示，该公司员工平均每年获得的股票薪酬约为150万美元，在过去25年科技

新创公司中处于最高水平。相关数据显示，OpenAI 现有约4000名员工。按通胀调整至2025年价格计算，其员工平均薪酬不仅明显高于其他同类企业，也远超多家知名科技公司上市前的水平。根据外媒引述薪酬顾问机构Equilar整理的统计，OpenAI 员工的平均股票薪酬，比Alphabet旗下谷歌2004年首次公开募股（IPO）前一年的员工股票薪酬高出6倍以上，同时约为另外18家大型科技公司上市前一年员工平均薪酬的34倍。该研究回顾了过去25年多家主要科技公司的IPO案例，其中包括Meta、Palantir等企业，相关薪酬数据均统一按通胀因素折算至2025年水平，以便进行横向比较。分析指出，为在人工智能领域的竞争中保持领先地位，OpenAI 持续向顶尖研究人员及工程师提供高额股票薪酬。一些员工因此迅速跻身硅谷高收入人群之列，成为当地收入最高的科技从业者之一。与此同时，这一薪酬结构也推高了公司的整体运营成本，并加快稀释现有股东的权益。报道提到，扎克伯格（Mark Zuckerberg）此前曾以总额达数亿美元的薪酬方案招揽人工智能人才，并从OpenAI 挖走20多名员工，进一步加大了OpenAI 在薪酬层面的竞争压力。

芯片短缺或致消费电子产品价格上涨20%

1月1日据《心安纪》报道，分析师和制造商警告称，由于人工智能需求推高了电子产品中使用的存储芯片成本，消费者应做好今年智能手机、电脑和家用电器价格上涨高达20%的准备。包括戴尔、联想、树莓派和小米在内的消费电子产品制造商警告称，芯片短缺可能会加剧成本压力，迫使他们提高价格，分析师预测价格涨幅将达到5%至20%。戴尔首席运营官杰夫·克拉克在11月份的财报电话会议上表示，该公司从未见过“成本以目前这样的速度增长”，而这种影响必然会波及消费者。英国PC制造商Raspberry Pi在12月份提高电脑价格时称成本压力“令人痛苦”，而全球最大的PC制造商联想的首席财务官Winston Cheng在11月份告诉彭博电视台，联想正在囤积内存芯片和其他关键组件。分析人士表示，为支持人工智能模型而在全球范围内建设的数据中心刺激了对尖端高带宽存储芯片的需求，导致芯片制造商降低了对消费电子产品中使用的低端半导体的优先级。这导致动态随机存取存储器（DRAM）芯片短缺，这种芯片广泛应用于从汽车到电脑的各种设备中，用于临时数据存储。因此，各公司纷纷囤积芯片，推高了半导体价格。麦格理分析师丹尼尔·金表示：“我们已经看到整个市场都出现了供应短缺。市场一片混乱，买家恐慌，无论他们愿意出多少钱，都难以买到足够的内存。”

2025牛市狂飙，全球500富豪财富暴增2.2兆美元

1月1日据《心安纪》报道，根据彭博亿万富翁指数，2025年全球最富有500人共增加2.2兆美元财富，增额创历史新高，因股市、加密货币及贵金属等市场全面繁荣，带动他们的资产价值飙升。彭博社报道，全球最富有500人因为2025年财富增长，合计净资产达到11.9兆美元。在美国总统特朗普2024年底当选后，他们的财产快速增长，但特朗普2025年4月实施关税政策，引发市场暴跌，导致他们的资产一度遭受疫情以来最大单日损失。AI热潮推升美国科技股人工智能，热潮持续推升美国大型科技股股价，带动市场上涨，彭博亿万富翁指数记录的所有新增财富中，约1/4来自8位富豪。这些富豪包括甲骨文（Oracle）创办人埃里森（Larry Ellison）、特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）、Alphabet共同创办人佩吉（Larry Page）、亚马逊（Amazon）

on) 创办人贝索斯 (Jeff Bezos) 等人。

百度，计划分拆昆仑芯业务并于港交所独立上市

1月2日据《IT之家》报道，百度集团宣布，昆仑芯已于1月1日通过其联席保荐人向香港证券交易所提交了上市申请表。在拟议的分拆完成后，昆仑芯预计仍将作为子公司。公开资料显示，昆仑芯为百度内部孵化的AI芯片公司（前身为百度智能芯片及架构部），专注于通用AI芯片的设计与生产，于2021年4月完成独立融资，首轮估值约130亿元。近两年来，昆仑芯业务增长迅速。在客户拓展方面，除了百度作为重要客户外，昆仑芯外部客户占比约40%，包括互联网巨头、手机厂商、运营商及央企等，其2024年公司营收超过10亿元，超过此前已申报上市的燧原科技、壁仞科技、沐曦集成电路，也超过了已经上市的摩尔线程和寒武纪。

华虹半导体拟斥资82.68亿元收购华力微97.4988%股权

1月2日据《IT之家》报道，华虹半导体于2025年12月31日发布公告，该公司计划通过发行股份方式，向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。根据官方披露的信息，华虹半导体拟以43.34元/股的价格，向华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金等4名交易对方合计发行股份1.91亿股，购买其合计持有的华力微97.4988%股权。标的资产评估值为84.8亿元，增值率为323.59%，本次交易价格为82.68亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份（锁定期6个月），募集资金不超过75.56亿元，用于华力微技术升级改造项目，华力微特色工艺研发及产业化项目，补充流动资金、偿还债务及支付中介机构费用。

三星半导体负责人全永铉：HBM4内存获客户“三星回来了”赞誉

1月2日据《IT之家》报道，三星电子联席CEO、设备解决方案部负责人全永铉在今日发布的2026新年致辞中提到，三星的HBM4内存产品展现了独特的差异化竞争力，从客户处获得“三星回来了”的赞誉。全永铉强调了三星电子可提供全栈半导体解决方案的优势。他提到三星必须重拾在存储器领域的根本技术竞争力，而晶圆代工业务则进入了高速增长期。这位三星半导体掌门人称必须运用最新AI技术与优质数据开发专属半导体的AI解决方案，并将其应用于半导体设计、研发、制造、质量控制的全流程，实现半导体技术革新；而公司运营逻辑应从产品导向往客户导向转型。

韩国产业研究院称，中国智能汽车、机器人、半导体竞争力已超越韩国

1月2日据《IT之家》报道，韩国国策研究机构“产业研究院”的最新报告显示，在机器人、自动驾驶、电动汽车相关领域，甚至是“支柱产业”半导体，韩国的竞争力已被中国赶超。报告显示，韩国在汽车、机器人、半导体等三大产业领域的竞争力，大部分已被中国超越。分析结果显示，中国半导体产业的综合竞争力与韩国并驾齐驱。在半导体产业的价值链评估项目中，中国在芯片研发(R&D)、成品生产、产品服务、国内需求4个项目中超越了韩国。相反，韩国仅在确保材料、零部件、设备等供应链和国外需求等方面优于中国。尤其是在半导体产业的细分领域技术、价格、基础设施等30个评估项目中，超过一半

的19个（63.3%）项目被评价为中国更具优势。究其原因，是除了存储器制造和晶圆代工技术之外，中国在性价比和基础设施领域具有优势。在包括AI芯片在内的半导体设计领域，技术、价格、基础设施都被评价为中国优于韩国。中国的机器人、电动汽车、电池、自动驾驶汽车综合竞争力已被评价为超过韩国。报道提到，在总分1-7分的项目中，如果分数高于中间值4分即被视为“中国优势”，低于4分则视为“韩国优势”。评估结果显示，自动驾驶汽车（5.3分）、机器人与电动汽车（各5.0分）、电池（4.8分）均是中国领先于韩国。

四、公司公告

雅葆轩：股东拟减持股份的预披露公告

公司于12月29日发布公告，公司及董事会全体成员、相关股东保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应连带责任。本次减持主体为公司控股股东、实际控制人、董事长胡啸宇，其当前持股25,759,500股，占公司总股本的32.1672%，股份来源为北交所上市前取得（含权益分派转增股）。根据公告，胡啸宇因自身资金需求，计划在公告披露之日起30个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持公司股份，拟减持数量不超过1,601,600股，占总股本比例不高于2%，且该减持数量可能超过公司股份总数的1%，减持价格将根据市场价格确定。

本川智能：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

公司于12月29日发布公告，董事会审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予相关议案，确定当日为首次授予日。本次激励计划采用第二类限制性股票，股票来源为公司定向增发A股普通股，授予总量183.55万股（占总股本2.37%），其中首次授予146.84万股（占比80%，总股本1.90%），预留36.71万股（占比20%，总股本0.47%）。激励对象共104人，含公司董事、高管及核心员工（不含独董、5%以上股东及亲属），授予价格25.43元/股，计划有效期最长不超过60个月。归属安排分三期，首次授予各期归属比例30%、30%、40%，对应归属期间自授予日起14-26个月、26-38个月、38-50个月；预留授予归属期间自授予日起12-24个月、24-36个月、36-48个月。业绩考核以2025年为基数，2026-2028年营收或净利润增长率分别不低于10%、20%、30%，个人考核按等级确定0%-100%可归属比例。本次激励产生的4519.38万元总成本将分期摊销，2026-2029年预计分别影响业绩2360.33万、1389.93万、674.14万、94.97万元，旨在激发员工积极性，助力公司战略目标实现。

芯原股份：关于作废处理部分限制性股票的公告

公司于12月29日发布公告，披露公司拟作废处理部分已授予但尚未归属的限制性股票，相关议案已于2025年12月29日经第三届董事会第八次会议审议通过。本次作废涉及两项激励计划，合计作废数量21.79万股。其中，2022年限制性股票激励计划方面，因预留授予部分第三个归属期未能满足对应业绩考核目标，所有激励对象该批次拟归属的限制性股票需作废，涉及数量21.64万

股（第二类限制性股票）；2025年限制性股票激励计划方面，因部分首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟作废其已获授但尚未归属的限制性股票0.15万股。公告明确，本次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司核心团队的稳定性及股权激励计划的后续实施。董事会薪酬与考核委员会已同意此次作废处理相关安排。

海光信息：海光信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

公司于12月29日发布公告，会议于2025年12月29日在北京市海淀区中关村软件园27号楼C座召开，由公司董事会召集，总经理沙超群主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的普通股股东共1395人，所持表决权合计16.0257亿股，占公司表决权总数的68.9473%；公司10名在任董事全部列席，董事会秘书及部分高管参与会议。本次会议核心审议通过《关于2025年中期现金分红方案的议案》，表决结果显示，同意票数16.0251亿股，占比99.9961%，反对4.9015万股（占比0.0031%），弃权1.3129万股（占比0.0008%）。分段表决中，持股5%以上及1%-5%的股东均全票同意；持股1%以下股东同意比例99.9619%（其中市值50万以下股东同意99.9188%，50万以上股东同意99.9721%）。中小投资者（5%以下股东）单独计票结果为同意2.5473亿股，占比99.9756%。

南芯科技：关于与关联方签署协议暨关联交易的公告

公司于12月29日发布公告，披露公司拟与关联方行至存储科技（苏州）有限公司签署《技术开发授权协议》暨关联交易相关事宜，该事项已通过公司董事会审议，无需提交股东会。关联关系方面，南芯科技持有苏州行至16.4706%股权并委派一名董事，苏州行至为公司联营企业，故本次交易构成关联交易，且不构成重大资产重组。苏州行至成立于2023年6月，主营存储芯片及嵌入式存储IP设计研发等，2024年营收202.53万元、净利润-573.26万元；2025年至今，公司已向其购买技术服务23.12万元、技术许可11.36万元。交易核心内容为公司委托苏州行至定制开发适配合作制造商及其产品的IP，并取得该IP永久许可。交易金额包括1500万元（含税）开发费用及按产品销量计算的权利金（设年度上限），开发费用分四期支付：签约后付750万元，后续三个开发节点分别付300万元、300万元、150万元。知识产权方面，双方背景知识产权归各自所有，公司可对授权IP（不含存储单元）修改创新，产生的新成果归公司所有；苏州行至的后续改进成果归其自身。本次交易旨在借助苏州行至的存储IP开发能力，助力公司业务发展、提升产品竞争力，不会影响公司独立性，亦不损害股东利益。

江波龙：关于拟购买控股子公司少数股东股权的公告

公司于12月30日发布公告，披露拟购买控股子公司少数股东股权相关事宜，该事项已于2025年12月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会。本次交易中，公司拟通过全资子公司Lexar Europe B.V.，以自有及或自筹资金4608万美元，向SMART Modular Technologies (LX) S.à.r.l.购买控股子公司Zilia Eletrônicos 剩余19%股权，交易后标的公司将成为江波龙全资子公司，合并报表范围不变。交易对方实际控制人为美国纳斯达克上市公司Penguin Solutions, Inc.，双方无关联关系。Zilia Eletrônicos

成立于2009年，主营通用存储器制造销售，在巴西市场处于领先地位，2024年经审计净利润1506万美元，2025年前三季度未经审计净利润3625万美元，本次交易标的公司估值2.5亿美元。交割日不晚于2026年4月28日，交割后受让方将价款支付至转让方指定账户。

佰维存储：关于购买股权暨与关联人共同投资的公告

公司于12月30日发布公告，披露购买股权暨与关联人共同投资相关事宜，该事项已于2025年12月29日经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会。本次交易中，公司全资子公司海南南佰算拟以自有或自筹资金（含银行贷款）2000万元，受让牛芯半导体（深圳）股份有限公司0.8446%股权（38.0066万股）。其中，以1000万元受让上海超越摩尔股权投资基金持有的19.0033万股，另1000万元受让苏州海松硬核科技股权投资基金持有的19.0033万股。本次交易构成关联交易，因公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金二期持有牛芯半导体 6.7568%股权，且公司实际控制人母亲徐林仙拟同步受让标的公司0.8446% 股权。牛芯半导体成立于2020年，主营集成电路研发销售，聚焦高速互连技术，产品应用于数据中心、AI等领域，服务超百家客户。交易资金在先决条件达成后15个工作日内全额付清，标的公司不纳入佰维存储合并报表。

颀中科技：合肥颀中科技股份有限公司部分高级管理人员减持股份计划公告

公司于12月30日发布公告，本次减持主体为公司高级管理人员周小青，截至公告披露日，其直接持有公司463541股股份，占总股本0.04%。该部分股份来源于公司首次公开发行前取得，已于2024年11月15日解除限售并上市流通，且上市以来周小青未减持过该部分股份。因个人资金需求，周小青计划自公告披露日起15个交易日后的3个月内（即2026年1月23日至2026年4月22日），通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，合计不超过115885股，占公司总股本比例不超过0.01%。减持价格将按市场价格确定，若公司在减持期间发生送红股、转增股本等除权除息事项，减持计划将相应调整。周小青此前已就股份锁定期、减持比例、减持价格等作出相关承诺，本次减持事项与承诺一致。

可立克：关于变更部分募集资金用途后签订募集资金三方监管协议的公告

公司于12月30日发布公告，披露变更部分募集资金用途后签订《募集资金三方监管协议》的相关情况。公司曾通过2020年、2022年两次非公开发行A股募集资金，后于2025年6月审议通过变更部分募集资金用途的议案：终止“惠州充电桩磁性元件智能制造项目”等三个项目，将未投入的17391.16万元募集资金（含利息）用于越南生产基地建设，并设立境外投资主体。其中，2025年6月成立全资子公司弘廷科技新加坡有限公司，2025年10月由其全资设立弘廷科技（越南）有限责任公司，作为项目实施主体。近日，越南弘廷在交通银行胡志明市分行开立募集资金专户，公司及新加坡弘廷、越南弘廷与交通银行深圳分行、中国银行新加坡分行、交通银行胡志明市分行及保荐机构招商证券签署《募集资金三方监管协议》。共开立四个专项账户（含人民币、美元、多币种账户），截至公告日余额均为0，资金仅允许在指定账户间划转及用于越南生产基地建设相关支出，保荐机构将履行半年度现场检查等督导职责。

复旦微电：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

公司于12月30日发布公告，披露作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事宜，该事项已于2025年12月30日经第十届董事会第七次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会已审议同意。本次作废的股票源自公司2021年限制性股票激励计划，作废原因系部分激励对象离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票按规则作废。具体来看，首次授予部分有34名激励对象离职，对应作废股票126250股；预留授予部分有6名激励对象离职，对应作废股票48000股，本次合计作废限制性股票174250股。公司2021年限制性股票激励计划已履行完整决策程序，此前已完成多期归属及部分股票作废事宜。公告明确，本次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队稳定性及股权激励计划的后续实施。相关作废事项已获得律师及独立财务顾问认可，符合激励计划相关约定。

英飞特：关于控股股东、实际控制人减持股份实施进展暨权益变动触及1%整数倍的公告

公司于12月31日发布公告，公司控股股东、实际控制人、董事长GUICHAO HUA此前于2025年9月22日披露减持计划，拟在2025年10月22日至2026年1月21日期间，通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过 842.057 万股（占总股本不超过 2.82%）。截至2025年12月29日，减持进展显示：2025年11月11日至12月29日期间，GUICHAO HUA通过集中竞价减持70.1203万股，大宗交易减持268.9474万股，合计减持339.0677万股。其持股数量从9841.4871万股降至9502.4194万股，持股比例从32.9658%降至31.83%，权益变动触及1%整数倍。公司当前总股本2.98536488亿股，扣除回购专用证券账户股份后为2.91046488亿股，变动后GUICHAO HUA持股占总股本31.83%、占扣除后总股本32.6491%。本次减持与此前披露的计划及承诺一致，尚未实施完毕，不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

希荻微：希荻微关于调整购买资产方案的公告

公司于12月31日发布公告，披露调整购买资产方案相关事宜，该事项已于2025年12月31日经第二届董事会第二十九次会议审议通过。公司原筹划发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金，该事项为重大资产重组，自2024年11月启动后，历经停牌复牌、股东会审议、上交所受理及中止恢复审核等流程。为提高交易效率、降低交易成本，结合公司发展规划与资本市场环境，公司决定撤回原重组申请文件，调整为以现金方式收购。新方案核心内容为：公司以3.1亿元现金收购诚芯微100%股份，交易完成后诚芯微将成为公司全资子公司，本次交易不再构成重大资产重组及关联交易。业绩承诺方面，交易对方承诺诚芯微2025-2027年净利润分别不低于2200万元、2500万元、2800万元，三年累计不低于7500万元。

希荻微：希荻微关于以现金方式收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的公告

公司于12月31日发布公告，拟以3.1亿元现金收购深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份，该事项已通过公司第二届董事会第二十九次会议审议，无需提交股东会。诚芯微成立于2009年，主营集成电路设计及进出口业务，2024

年经审计净利润2170.89万元，2025年上半年净利润1228.55万元，股权由曹建林（66.89%）、曹松林（16.72%）等四人合计持有。交易定价参考评估值（3.12亿元）协商确定，评估增值率171.50%。业绩承诺方面，交易对方承诺诚芯微2025-2027年净利润分别不低于2200万元、2500万元、2800万元，累计不低于7500万元；若2026-2027年净利润合计超额，将对经营团队给予现金奖励。支付方式为分期付款：协议生效后5个工作日内付定金800万元，交割后3个工作日内付1.501亿元（含应付税款），剩余款项按业绩完成情况支付。交割需在2026年2月15日后45日内完成，且诚芯微需先由股份公司变更为有限公司。

联动科技：关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告

公司于12月31日发布公告，披露调整2023年限制性股票激励计划相关事项，该事项经第二届董事会第二十四次会议审议通过。公司2023年限制性股票激励计划已于2023年12月经股东大会审议通过，后续完成首次授予、预留授予及多期归属/解除限售等事项。本次调整源于2025年半年度利润分配方案的实施：公司于2025年9月25日股东会通过利润分配预案，10月22日正式实施，以剔除回购股份后的6995.2451万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股、不资本公积转增股本。根据激励计划及股东大会授权，董事会对激励计划相关价格进行调整：第二类限制性股票授予价格与第一类限制性股票回购价格，均由33.62元/股调整为33.47元/股。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。公告明确，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，董事会薪酬与考核委员会已同意该调整事项。露日，梁国豪先生持有公司股份16,403,261股，占公司总股本的8.08%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。梁国豪先生本次所持公司部分股份被司法拍卖事项不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司的生产经营造成影响。届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。定向回购类型为股权激励计划限制性股票回购注销，公司拟对3名激励对象持有的已获授但尚未解限售的24,500股限制性股票予以回购注销。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2026（第十六届）中国互联网产业年会	1.7-1.8	北京中关村 国家自主创新示范区展示中心	中国互联网协会
2	2026 年人工智能与社交网络系统国际学术会议暨智能计算与网络安全研讨会（WICNS 2026）	1.10-1.11	江门市（另设杭州主会场）	IEEE 支持，AISNS 2026 组委会，五邑大学等高校
3	2026 年人机交互、神经网络与深度学习国际学术会议（HNNDL 2026）	1.9-1.11	上海市	上海大学、IEEE 等

公司会议			
序号	公司名称	会议名称	会议时间
1	芯瑞达	股东大会举办	2026-01-09
2	飞凯材料	股东大会举办	2026-01-09
3	长川科技	股东大会举办	2026-01-09
4	佳禾智能	股东大会举办	2026-01-09
5	英集芯	股东大会举办	2026-01-09
6	清越科技	股东大会举办	2026-01-09
7	胜蓝股份	股东大会举办	2026-01-08
8	盛美上海	股东大会举办	2026-01-08
9	至正股份	股东大会举办	2026-01-07
10	南亚新材	股东大会举办	2026-01-07
11	艾为电子	股东大会举办	2026-01-07
12	康强电子	股东大会举办	2026-01-06
13	漫步者	股东大会举办	2026-01-06
14	共达电声	股东大会举办	2026-01-06
15	瀛通通讯	股东大会举办	2026-01-06
16	奕东电子	股东大会举办	2026-01-06
17	天山电子	股东大会举办	2026-01-06

18	沃尔核材	股东大会举办	2026-01-05
19	维信诺	股东大会举办	2026-01-05
20	长盈精密	股东大会举办	2026-01-05
21	协创数据	股东大会举办	2026-01-05
22	普冉股份	股东大会举办	2026-01-05
23	华岭股份	股东大会举办	2026-01-05

数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		限售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688220.SH	翱捷科技	2026-01-05	873.12	41,830.09	36,040.82	86.16	36,913.93	88.25	首发原 股东限 售股份
688322.SH	奥比中光	2026-01-07	2,643.61	40,114.42	29,224.03	72.85	31,867.64	79.44	追加承 诺限售 股份上 市流通
688729.SH	屹唐股份	2026-01-08	1,521.32	295,556.00	19,978.77	6.76	21,500.09	7.27	首发机 构配售 股份
605277.SH	新亚电子	2026-01-09	167.93	32,398.78	31,813.48	98.19	31,981.41	98.71	股权激 励限售 股份
600237.SH	铜峰电子	2026-01-09	295.45	63,070.42	62,167.62	98.57	62,463.06	99.04	股权激 励限售 股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所整理

金元证券行业投资评级标准:

增持: 行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘;

中性: 行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平;

减持: 行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

2026 年 1 月

